

臺北市政府 函

地址：臺北市信義區市府路1號9樓
承辦人：郭芳瑜
電話：02-27208889/1999轉8268
傳真：02-27593317
電子信箱：udd-kfy1991@mail.taipei.gov.tw

受文者：臺北市建築師公會

發文日期：中華民國108年10月9日
發文字號：府授都規字第10830902673號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：計畫書1份

主旨：檢送本市都市計畫「修訂『擬定臺北市北投士林科技園區（區段徵收範圍）細部計畫案』土地使用分區管制暨都市設計管制要點案（第二次修訂）」發布實施公告文、計畫書1份，請查照辦理。

說明：

- 一、請依都市計畫法第23條規定，將公告文及計畫書，於貴區公所公告欄公告，並請經常保持清晰完整。
- 二、配合本府推動公文資訊化業務及電子公文節能減紙政策，副本單位除另有標註者外，其餘單位請逕至本府都市發展局網站\公展公告\都市計畫公告項下下載計畫書。

正本：臺北市北投區公所

副本：臺北市議會、臺北市建築師公會、台北市不動產開發商業同業公會、財政部國有財產署北區分署、臺北市稅捐稽徵處、臺北市北投區建民里辦公處、臺北市北投區洲美里辦公處、臺北市政府都市發展局建築管理科、臺北市政府都市發展局都市設計科(以上單位請依說明二辦理)、臺北市都市計畫委員會(含附件)、臺北市政府都市發展局(含附件)、臺北市政府地政局(含附件)、臺北市建築管理工程處(含附件)、臺北市政府產業發展局(均檢附計畫書各1份)(含附件)、臺北市政府都市發展局都市測量科(檢附計畫書3份)(含附件)

